

华创证券有限责任公司
关于气派科技股份有限公司
2022年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责气派科技首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具2022年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与气派科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解气派科技的业务发展情况，对气派科技开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022年上半年度，气派科技在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022年上半年度，气派科技及相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导气派科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促气派科技依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对气派科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，气派科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促气派科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对气派科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	保荐机构关注到2022年上半年度气派科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上	保荐机构关注到2022年上半年度气派科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	持续督导情况
	海证券交易所报告	
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的	保荐机构关注到2022年上半年度气派科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022年上半年度，气派科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，将按计划以及相关规定开展现场检查
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	保荐机构关注到2022年上半年度气派科技不存在前述情形
17	持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	2022年上半年度，保荐机构持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况等承诺事项

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构对气派科技本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，气派科技严格按照证券监管机构的相关规定进行

了信息披露，依法及时公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、集成电路封装测试领域技术及产品升级迭代风险

近年来，集成电路终端系统产品的多任务、小体积的发展趋势带动了集成电路封装技术朝着高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化、小型化方向快速发展，相应的FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV等先进封装技术应用领域越来越广泛。日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面的掌握FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV等先进封装技术，而公司产品目前仍以SOP、SOT等传统封装形式为主，报告期，公司先进封装占主营业务收入仅为27.59%，相应的公司产品面临技术升级迭代风险。如果未来公司的封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代，将可能使得公司市场空间变小；或者公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入，或者正在研发的新产品不能满足客户需要，将难以开拓新的业务市场；进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、研发技术人员流失风险

公司自成立以来一直从事集成电路封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着集成电路封装测试市场竞争的不断加剧及新的参与者加入，企业之间对人才尤其是优秀研发技术人员的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待

遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现研发技术人员流失，公司还将面临技术泄密的风险。

（二）市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对集成电路行业的大力支持，使大量资金涌入集成电路行业，各地争先恐后的上马集成电路项目，当大量的集成电路封测项目投产后，会造成市场竞争加剧，如果公司不能持续保持较强市场竞争力，将对公司经营造成不利影响。

（三）经营风险

1、业绩大幅下滑或亏损的风险

受产业周期性波动和疫情的影响，消费电子、5G通信等市场发展不及预期，消费类芯片产品市场需求逐渐放缓，半导体封测行业整体订单量也随之出现下滑。公司产品中应用于消费电子类占比较高，在半导体封测行业市场整体需求出现疲软时，公司订单受一定程度的影响，产能利用率不足，可能导致公司业绩大幅下滑。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、丝材（金丝、银线、铜线、合金线）和装片胶。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

（四）新冠疫情风险

新冠疫情仍在全球蔓延，国内多地区的疫情出现反复，可能使公司的原材料供应、产品运输等生产经营造成影响。为了防控疫情，公司组建了疫情防控小组，疫情防控小组随时关注国内疫情动态，认真研判疫情形势，毫不松懈的落实、落细、落地各项防控措施，统筹部署疫情防控方案，保障了公司生产经营的正常运行。

五、重大违规事项

2022年上半年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2022年上半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2022年1-6月	2021年1-6月	增减变动幅度（%）
营业收入	28,720.15	36,621.84	-21.58
归属于母公司所有者的净利润	-65.25	6,803.91	-100.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-896.97	6,588.76	-113.61
经营活动产生的现金流量净额	1,475.16	7,264.62	-79.69
归属于上市公司股东的净资产	100,087.92	100,153.17	-0.07
资产总额	173,179.01	184,521.00	-6.15

2022年上半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2022年1-6月	2021年1-6月	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.85	-101.18
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.85	-101.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.08	0.83	-109.64
加权平均净资产收益率（%）	-0.07	11.74	减少11.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.90	11.36	减少12.26个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.79	5.73	增加4.06个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、营业收入变动原因说明：报告期内，营业总收入较上年同期下降21.58%，主要原因系公司产品主要应用于消费电子，受产业周期和疫情影响，消费电子市场表现不及预期，叠加受华南、华东地区疫情影响，订单有所下降；同时部分产品销售价格有所下降。

2、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、稀释每股收益（元/股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）、加权平均净资产收益率（%）、扣除非经常性损益后的加权平均净

资产收益率（%）的变动原因说明：报告期，受国际宏观经济环境、产业周期性波动、疫情停工以及供应链的影响，消费电子等终端设备的需求不及预期，消费类芯片需求有所下滑，根据国家统计局公布的数据，今年上半年（1-6月）我国集成电路产量合计为1661亿块，同比下滑6.3%，为2009年以来同比增速首次转负。公司应用在消费电子类产品的订单有所下滑，叠加深圳、东莞、上海疫情的影响，公司产能利用率下降，同时公司产能扩充过程中，人工成本、机器折旧等固定成本有所增加，导致公司业绩有所下滑。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是营业收入减少，客户回款减少所致，二是营业成本增加，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。

综上，公司2022年上半年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

七、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）技术优势

集成电路封装测试属于技术密集型行业，行业创新主要体现为生产工艺的创新，技术水平主要体现为产品封装加工的工艺水平。气派科技通过多年的技术研发积累与沉淀，现已形成了5G MIMO基站GaN微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、产品性能提升设计技术、精益生产线优化设计技术等核心技术，推出了自主定义的CDFN/CQFN、CPC和Qipai封装系列产品，对贴片系列产品予以了优化升级等，并已申请了发明专利。

（二）人才优势

气派科技的多数高级管理人员及部分核心技术人员拥有多年的集成电路技术研发或管理经验，具备国际领先企业的行业视野或国内一流企业的从业经验，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力、设计新产品、开发新工艺提供强有力的人力资源支持。截至2022年6月30日，公司拥有研发技术人员237人，占员工总人数的12.56%。

公司不仅在研发人员及管理团队中具备人才优势，也将人才优势进一步推广到生产一线，为近年来公司精益生产线优化设计技术的深层次应用奠定了人力资源基础。公司组织了后备经理人培训、一线主管技能培训班组长培训、东莞市“一镇一品”特色人才培养、“新生力培训计划”、与东莞职业技术学院合作开展东莞市职业技能培训标准开发、职业技能等级自主认定等，不断完善产线员工技能培训体系。

（三）生产组织与质量管理优势

集成电路封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、DIP等系列。相对齐全的产品线为公司满足客户多元化的产品需求和建立市场优势发挥了重要作用。但同时，不同的产品类型往往需要不同生产工艺、生产设备、供应商体系、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，培养了经验丰富的研发技术人员和一大批生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量、工艺控制制度，并通过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF14969:2016汽车行业质量管理体系与ISO14001:2015环境管理体系认证，正在导入六西格玛（6 σ ）管理工具。

（四）地域优势

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户的交流和反馈，增强其竞争力。

公司地处深圳，电子元器件配套市场的迅速崛起以及半导体设计行业的蓬勃发展为气派科技提供了快速发展的沃土。公司充分发挥地域优势进行客户开

拓，通过上门接送货物等服务方式节约运输时间、缩短交货期和降低物流成本，加深与客户的交流，销售服务利于得到客户认可，提高公司市场占有率。

（五）规模优势

芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。为构建公司在国内封装测试行业的规模优势，公司在东莞投资完成了自有厂房的建设，为持续的产能的扩充以及技术改造提供了物理条件。

公司现已发展成为华南地区规模最大的内资封装测试企业之一，2021年公司集成电路封装测试销量为103.70亿只，2022年上半年销售量为39.86亿只，已形成了自身的规模优势。同时，公司仍在进行持续的资本性支出，不仅提升了公司技术层级，丰富了产品类别，优化了客户结构，还使得公司产能和销售规模也得到进一步提升，继续利用规模优势来巩固和提高公司在行业内的竞争地位。

综上所述，2022年上半年度气派科技核心竞争力未发生重大不利变化。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2022年上半年，公司的研发投入的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	2,812.23	2,099.90	33.92
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	2,812.23	2,099.90	33.92
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.79	5.73	增加4.06个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

2022年上半年，公司的主要在研项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大功率电源管理模组及芯片封装关键技术研发	2,000.00	303.83	1,793.78	小批量试生产阶段	开发一款电源管理模组，填补特定功率市场空白，并形成稳定可量产的封装技术和生产线	行业先进水平	项目产品主要应用于消费类电子产品
2	超大功率高散热氮化镓第二代5G基站产品研发及产业化	671.00	141.64	610.92	小批量试生产阶段	开发第二代散热及性能更好的5G基站用GaN射频器件，适用于更严苛的使用环境条件	行业先进水平	项目产品主要应用于5G基站
3	保护充电电路过载的芯片封装技术开发	483.00	26.05	30.59	设计开发验证阶段	设计开发一种应用于保护充电电路过载的芯片封装技术产品	达到行业内同类型封装产品先进水平	项目产品广泛应用于各种具有充电装置及电路的电子、电器等设备
4	一种低成本高效率引线框架技术的开发	960.00	127.65	127.65	设计开发验证阶段	设计开发一款SOP类高密度的引线框架，阵列密度超出业内最高的20%以上，框架利用率超出业内最高的12%以上	行业先进水平	项目产品广泛应用于各种电子、电器等设备的控制电路和驱动电路，如儿童玩具、家电、话筒等
5	激光开槽新技术开发	500.00	38.85	38.85	小批量试生产阶段	建立切割道low K 晶圆和GaN晶圆激光开槽量产工艺平台	达到行业内同类工艺先进水平	广泛应用于硅基GaN芯片切割分离
6	大功率MOSFET封装开发及产业化	900.00	0.32	0.32	设计开发验证阶段	建立至少一款大功率MOSFET芯片用封装量产平台，填补公司在功率器件方面空白	行业先进水平	广泛应用在工控和汽车领域，如光伏逆变器、电动工具等
7	指纹识别芯片的SIP封装技术研发及产业化	1,500.00	218.69	1,199.81	工艺开发验证阶段	设计一种适用于客户指纹芯片的封装基板，并开发一整套完整的SIP封装工艺方案，同时能达到客户严苛的尺寸、翘曲度要求	行业先进水平	项目产品主要应用于消费类电子产品
8	5G宏基站超大功率超高频异结构GaN功放塑封封装技术及产业化	3,100.00	422.29	1,759.07	工艺开发验证阶段	设计超大功率超高频异结构GaN功放塑封封装，突破行业内的金属陶瓷封装技术制约，大大降低成本	达到国内5G大功率封装领先水平	项目产品主要应用于5G宏基站
9	MEMS硅麦器件封装技术研发及产业化	1,500.00	309.98	1,019.05	部分小批量生产，部分大批	在公司现有制程能力基础上开发一整套完整的MEMS硅麦产品制程工艺方案，同时	行业先进水平	项目产品广泛应用于消费电子，如手机、电脑等

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	化				量生产阶段	满足客户的可靠性要求		
10	存储芯片封装技术开发	550.00	296.34	402.01	小批量试生产阶段	开发多款应用于存储芯片的高可靠性、低成本的封装，其中包括不同外形尺寸与不同基岛尺寸的DFN/QFN封装	行业先进水平	项目产品广泛应用于存储芯片
11	高可靠RFID技术封装开发	700.00	168.10	168.10	小批量试生产阶段	在公司现有制程能力基础上开发基于QFN的射频芯片封装并实现产业化	行业先进水平	广泛应用于笔记本、无线鼠标、Wifi以及智能家居
12	电源管理芯片高可靠性多样化封装及其产业化	1,000.00	231.66	237.74	小批量试生产阶段	开发多款应用于电源管理芯片的高可靠性、低成本的封装，其中包括不同外形尺寸与不同基岛尺寸的DFN/QFN封装，进而完善电源管理芯片封装技术方案。	行业先进水平	项目产品主要应用于激光雷达、TWS充电桩等。
13	智能电机驱动芯片封装技术开发	850.00	132.31	136.68	小批量试生产阶段	设计开发目前DFN/QFN最大规格尺寸的产品，提供可靠且稳定的封装技术，实现客户可靠性要求的前提为IPM产品提供一套完整的封装方案并实现稳定生产。	行业先进水平	项目产品主要应用家用电器，如冰箱、吸尘器、空调、风扇等。
14	中小功率控制芯片大矩阵封装技术开发及产业化	755.00	104.43	104.43	工艺开发验证阶段	建立大矩阵框架的封装平台并实现产业化，框架矩阵由28颗提升到90颗	行业先进水平	应用范围包括标准逻辑IC、存储器LSI、微机电路等
15	基于SOT系类的铜凸块焊接封装技术开发	867.00	116.97	116.97	小批量试生产阶段	建立基于铜凸块焊接工艺的芯片封装量产平台，填补公司在倒装焊工艺和产品方面空白	行业先进水平	项目产品主要应用于消费终端如电脑等领域
16	镍钎金(PPF)引线框架封装技术开发	850.00	148.05	159.63	工艺开发验证阶段	完成4X4、3X3、2X2、1X1等镍钎金(PPF)框架产品达到MSL3、MSL1的可靠性要求，完成PPF框架产品的量产	行业先进水平	RF射频器件、家电、汽车电子等
17	智能功率模块封装技术开发及产业化	1,500.00	19.92	19.92	项目立项阶段	建立至少1款IPM封装生产平台并产业化	行业先进水平	主要应用于各种白色家电，如洗衣机、油烟机、洗碗机、空调、电风扇等
18	一种带引脚QFN产品研发及	650.00	3.62	3.62	设计开发验证阶段	建立创新型的封装生产平台并产业化	业内领先	用于笔记本电脑、数码相机、个人数字

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	产业化							助理(PDA)、移动电话和MP3等便携式消费电子产品
19	低成本超高密度TSSOP8(11R)引线框架开发	650.00	1.54	1.54	设计开发验证阶段	设计开发一款SOP类高密度的引线框架, 框架利用率超出业内最高的20%以上	业内领先	项目产品广泛应用于各种电子、电器等设备的控制电路和驱动电路, 如儿童玩具、家电、话筒等
合计	/	19,986.00	2,812.23	7,930.66	/	/	/	/

报告期内获得的知识产权如下:

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	16	2	77	13
实用新型专利	16	7	147	128
外观设计专利	0	0	101	71
软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	0	0
合计	32	9	326	213

注: 以上累计数量统计中不含已失效专利。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月18日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1714号), 同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,570,000股, 募集资金总额为人民币39,376.74万元, 扣除发行费用合计人民币5,554.28万元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币33,822.46万元。上述募集资金已于2021年6月17日全部到位, 并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验, 并出具了编号为天职业字[2021]33490号的《验资报告》。

募集资金到账后, 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理, 开立了

募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司除对闲置资金进行现金管理外累计使用募集资金人民币 27,977.02 万元，尚未使用的募集资金余额 6,240.57 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 6,240.57 万元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
IPO 募集资金净额	338,224,573.85
加：利息收入	3,953,633.44
减：募投项目累计资金使用情况	279,770,187.50
减：手续费支出	2,270.00
2022 年 6 月 30 日募集资金余额	62,405,749.79
其中：专户存款余额	48,405,749.79
理财产品余额	14,000,000.00

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存入方式	期末余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行	669174492837	活期存款	1,650,800.59
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	03004561359	活期存款	10,303.03
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604264	活期存款	46,350,053.68
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604014	活期存款	394,592.49
合计			48,405,749.79

注：截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品余额 1,400.00 万元。其中，中国银行 669174492837 账户 1,400.00 万元。

公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年6月30日，气派科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	期初持股数（股）	期末持股数（股）
梁大钟	董事长、总经理、核心技术人员	51,150,000	51,150,000
白璎	董事	10,800,000	10,800,000
施保球	核心技术人员	2,000,000	2,000,000
李泽伟	董事、财务总监	295,000	295,000
赵红	监事	90,000	90,000
文正国	副总经理、董事会秘书	310,000	310,000
饶锡林	副总经理、核心技术人员	280,000	280,000
陈勇	副总经理	250,000	250,000
胡明强	副总经理	300,000	300,000

截至2022年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十二、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，气派科技不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：  
杨锦雄 孙翊斌

